

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-077

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于竞得国有建设用地使用权并签署成交确认书暨 投资项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资进展情况概述

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议的议案》。公司与安徽合肥新站高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合作协议，公司拟在位于合肥新站高新技术产业开发区的合肥综合保税区内投资建设汇成二期项目。项目占地约57亩，计划分阶段进行投资建设。第一阶段总投资约10亿元，主要用于拓展先进封装测试产能，并依托现有技术延伸产线工艺至车载芯片封装测试等领域。项目后续阶段投资计划视公司第一阶段投产情况及市场环境等因素另行协商确定。公司拟在项目第一阶段先行投资约6亿元用于新建车载显示芯片项目。具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签署项目投资合作协议的公告》（公告编号：2023-053）。

2023年12月29日，公司在合肥市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号为新站区工业360号地块的国有建设用地使用权，并与合肥市自然资源和规划局签署了《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书（工业）》（以下简称“成交确认书”）。

公司本次对国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、成交确认书主要内容及国有建设用地使用权相关情况

（一）成交确认书主要内容

1、交易主体

出让人：合肥市自然资源和规划局

竞得人：合肥新汇成微电子股份有限公司

2、主要内容

（1）竞得的编号为新站区工业 360 号地块的国有建设用地使用权，宗地面积 57.0124 亩（具体面积以实际测绘为准），成交单价为每亩人民币 25.6 万元。竞得人缴纳的竞买保证金自动转作受让地块的定金。

（2）竞得人应当于 2024 年 1 月 15 日前，持成交确认书与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，不按期签订的，视为竞得人放弃竞得资格，并承担相应法律责任。

（二）本次竞买的国有建设用地使用权基本情况

1、地块编号：新站区工业 360 号

2、地块位置：合肥市铜陵北路与项王东路交口西北角

3、土地用途：工业用地

4、出让年限：50 年

三、对公司的影响

公司本次竞得的国有建设用地使用权，地处位于合肥新站高新技术产业开发区内的合肥综合保税区，紧邻公司现有生产经营办公场地，能够与公司现有生产区域形成良好协同，有利于公司进一步完善产业布局，把握行业发展机遇，扩大公司生产规模，提升产能和市场占有率，增强公司综合竞争力，符合公司中长期发展战略规划，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，符合全体股东的长远利益。

四、相关风险提示

公司本次竞得国有建设用地使用权尚需签署国有建设用地使用权出让合同、支付出让金，并办理相关权属证书等工作，可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。公司将遵守相关法律法规，积极推进有关事项的落实，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年12月30日